



H2154

环氧导电银胶

H2154 是一款单组份导电银胶，主要应用于大功率 LED 及高功率 IC 模块的粘接。产品具有极高的导热性，良好操作性可点胶可印刷。该产品不含溶剂并且无渗出，环保并且储存稳定。

产品描述

产品参数

条目	规格	测量方法
外观	银色膏状	目视
粘度 cps	~25000	Brookfield粘度计, 5rpm
触变指数	5.6	5/20rpm
玻璃化 转变温度 Tg (°C)	140	DMA 法
体积电阻率 (Ω .cm)	2×10 ⁻⁵	两点探针法
导热率 (W/mk)	25	Laser Flash 法
粘接强度 (N)	40 (@ 常温)	1mm Si 芯片 Ag/Cu 基板
	20 (@ 260°C)	
固化条件	1.5hrs@180°C	

产品优点

- 良好的操作性
- 适合中高功率 LED 芯片粘接
- 优异的粘接性能
- 符合 RoHS 法规

使用方法

- **解冻：**使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间 1h。解冻后擦干针筒表面冷凝水后方可使用。
- **使用：**银胶解冻后需在 12h 内使用完，建议室温 25°C，湿度 60%RH 环境下使用。
- **固化：**1.5hrs@180°C。



标准包装

- 5ml/ 支、10ml/ 支、30ml/ 支
- 按客户需求包装

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域，防潮、防止污染、避免高温。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳运输、存储条件：-40℃，保存在避免直射光线的阴凉处，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com